



達能科技簽署新臺幣9.2億元聯合授信合約

太陽能矽晶圓廠達能科技(股票代號:3686)今日(9/17)與中國信託商業銀行等 11 家銀行共同簽署新臺幣 9.2 億元聯合授信合約。簽約儀式由達能科技趙元山董事長與各銀行代表共同主持。

本次聯貸案參貸銀行計有中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、玉山商業銀行、全國農業金庫、合作金庫商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣中小企業銀行、彰化商業銀行、臺灣銀行及華南商業銀行等十一家銀行，並由中信銀擔任管理銀行。本次聯貸案資金主要用途係用以償還金融機構借款及強化營運資金結構。

太陽能產業歷經兩年多之產業低潮，讓產業各環節之多數國內外公司面臨極大之財務壓力。達能科技自成立以來，向以穩健之財務結構為其經營基礎，而達能於今日與銀行團簽署新聯貸案，將於資金動用後使公司財務結構更加穩健，除顯示銀行對於公司經營團隊的信任及支持外，就中長期營運而言，將使達能與客戶及供應商之合作關係更加密切。

目前全球太陽能產業正逐漸恢復供需平衡並朝向穩健發展的道路，而達能在產品品質與轉換效率上所擁有之優勢，已使公司業績達近 13 個月新高。為因應逐漸增溫的市場需求，公司正持續並積極招募工程人員以擴大高效產品之產出，未來營運獲利將朝正向持續發展。

聯絡人：

吳育宜 執行副總經理
pr@danentech.com
+886 3 4738788

關於達能：

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化矽晶產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有兩座晶圓製造廠。經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技產品已為多數國際太陽能電池大廠所認證，未來期以成本競爭力、客製化服務及優異品質，繼續為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。